

ZX-E 型

BGA 维修站

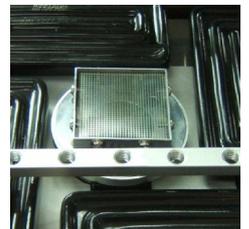


特点

- 采用视像对位系统、三个独立温度一体化设计，温度控制更准确，对小间距BGA、无丝印框、丝印框移位进行精确对位贴装，90° 旋转热风头进行焊接；
- 设备可接进计算机控制，测试温度曲线，互相传输温度曲线参数；
- 第一温区、第二温区加热器采用优良的发热材料，能精确调节热风流量和温度，产生高温微风，第三温区采用远红外发热板预热；
- 第一温区、第二温区以8段升(降)温+8段恒温控制，可储存10组温度曲线；
- 第一温区、第二温区同时启动运行温度曲线，第三温度与第一温区、第二温区同时启动升(降)温；
- 第一温区、第二温区带超温保护设计；
- 第一温区加热器可前后、上下调节，方便操作；
- 第二温区可根据不同PCB板外型、元件不同高度进行上下调节，防止与板底元件碰撞；
- 拆、焊接完毕后采用大流量恒流扇对PCB板进行冷却，防止PCB板变形，保证焊接效果；
- PCB卡爪可调式设计，防止与元件碰撞；
- 配有多种尺寸热风喷嘴，或根据特殊要求进行定做；热风嘴可360度任意旋转，易于更换；
- 可调式PCB支架，定位机架防烫手保护设计；
- 上部加热器带超温保护；
- 拆、焊接完毕后具声音报警功能；
- 手持式真空吸笔吸走BGA，方便、可靠、耐用。



A.90度旋转加热器

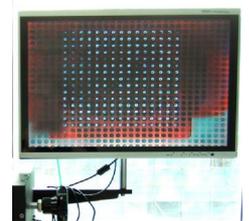


B.第二温区加热器

A.90度旋转加热器：在对位贴装完毕后，将光学对位系统、上部加热器同时旋转90度，对BGA进行焊接；热风喷嘴可360度任意旋转，适应不同角度BGA

B.第二温区加热：热风喷嘴采用耐高温、耐腐蚀材料、喷嘴可360度任意旋转，适应不同角度BGA；精确控制BGA底部PCB板的温度、预热时间。

C、D.摄像对位系统：利用光学系统将BGA锡球盘与PCB板焊盘以不同颜色呈现在液晶显示屏上，对不同大小的BGA可进行1~220倍放大,再利用X、Y及角度微调进行对位。



C.摄像对位系统



D.摄像对位系统

技术参数

项目	说明
应用范围	锡膏、IC31脚、空PCB、BGA/CSP/FC、红胶直径
可视范围	3.6×3mm
量测项目	高度、体积、面积、距离
倍率	60倍
台面尺寸	320(W)×450(L)
重复精度	0.008mm
分辨率	±0.004mm
检查方式	Laser Vision
数据保存方	Excel报表
测量范围	300×280mm
镜头彩色	CCD读取图像镜头组
对焦	手动对焦装置
操作方式	可英文、简体中文、繁体中文切换
计算机系统	操作系统WindowsXp、内存256M以上、显示器：15"LCD